

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-005

上海硅产业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人：太原晋科硅材料技术有限公司（以下简称“晋科硅材料”），为公司控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为晋科硅材料提供不超过人民币36亿元的担保；截至本公告日，公司未向其提供担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）情况概述

因业务发展需要，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司晋科硅材料拟向银行申请贷款，公司拟为其提供连带责任担保，担保总额不超过36亿元人民币。

（二）审批程序

公司于2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：太原晋科硅材料技术有限公司
- 成立日期：2024年7月15日

3、注册资本：550,000万(元)

4、注册地址：山西省太原市中北高新技术产业开发区柏板路69号

5、法定代表人：李炜

6、经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司通过全资子公司上海新昇半导体科技有限公司间接持有其45.46%股权。

8、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，晋科硅材料总资产为342,505.51万元，净资产295,647.85万元；2024年度，实现营业收入2,016.61万元，净利润-9,352.15万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司以及各子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

同时，提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

四、担保的原因及必要性

公司为控股子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足子公司日常经营及项目建设资金的需求，有助于公司的持续发展。被担保对象晋科硅材料为合并报表范围内的控股子公司，目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，不考虑本次担保事项，公司对外担保总额为人民币542,103万元（其中：为全资子公司担保342,103万元，为控股子公司担保200,000万元），占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是35.87%和18.67%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025年2月13日